

部品内蔵向けボンダー技術

新井 義之*

Bonding Tecnology for Embedded Package

Yoshiyuki ARAI*

* 東レエンジニアリング株式会社開発部門商品開発センター (〒 520-2141 滋賀県大津市大江1丁目1-45)

* Solition Center Reseach & Development Div., Toray Engineering Co., Ltd. (1-45, Oe 1-chome, Otsu, Shiga 520-2141)